



## 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年11月14日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス  
コード番号 6890 URL <https://www.ferrotec.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢  
問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186  
四半期報告書提出予定日 2023年11月14日 配当支払開始予定日 2023年12月11日  
四半期決算補足説明資料作成の有無： 有  
四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨)

### 1. 2024年3月期第2四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年9月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	105,494	8.2	13,035	△23.6	15,217	△35.4	8,390	△47.5
2023年3月期第2四半期	97,505	63.0	17,061	59.3	23,554	88.9	15,979	△7.4

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 24,733百万円 (△38.4%) 2023年3月期第2四半期 40,148百万円 (76.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	178.78	166.46
2023年3月期第2四半期	352.88	340.76

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第2四半期	476,576	271,834	42.0	4,255.40
2023年3月期	410,648	249,656	44.7	3,916.07

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 199,937百万円 2023年3月期 183,729百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	50.00	—	55.00	105.00
2024年3月期	—	50.00	—	—	—
2024年3月期（予想）	—	—	—	50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

### 3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	220,000	4.4	27,000	△23.0	28,000	△34.0	15,000	△49.5	319.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期2Q	47,078,667株	2023年3月期	47,011,067株
② 期末自己株式数	2024年3月期2Q	94,305株	2023年3月期	94,305株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期2Q	46,931,000株	2023年3月期2Q	45,282,920株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）は、2023年12月6日に質疑応答を主目的としたオンライン（WEB）での開催を予定しております。

決算説明資料については、2023年11月30日に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更)	10
(セグメント情報等)	11
(重要な後発事象)	13

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における経営環境については、米国景気は良好な雇用情勢を反映し個人消費や非製造業を中心に堅調ですが、製造業は金利上昇の影響等から景況感がやや悪い状況です。欧州はユーロ圏、英国ともインフレ圧力が強く金融引き締めが継続されていますが、景気への下押しも懸念され金利上昇も徐々に低下すると見込まれています。日本は燃料・電力の価格上昇影響は続くものの、雇用環境の改善、自動車等の輸出増、インバウンド消費の回復などにより経済状況は概ね良好に推移しました。中国は輸出の低迷、不動産市場の悪化などもあり景気は減速、金融緩和や財政支出等の下支え措置がとられている状況です。

為替相場は、対米ドルレートは春以降円安方向に転じて以降、秋にかけさらに円安が進みました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体産業の需要調整局面となり、半導体製造装置の需要も高水準であった前年と比較して需要が低迷しております。一方、パワー半導体や太陽光パネルの市場は比較的堅調に推移しております。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や受託加工、及び半導体製造プロセス向けの各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）などは欧米顧客を中心に売上が伸び悩みました。一方、CVD-SiC製品や石英坩堝は出荷が伸び、他事業の売上減をカバーしました。

電子デバイス事業では、サーモモジュールが前年高水準だったPCR検査装置向け出荷の減少もあり軟調でしたが、パワー半導体用基板は、産業機器向けやEV（電気自動車）向けの販売を引き続き伸ばしております。

なお、営業利益は、高度技術者等の積極的な採用、研究開発を進めたことによる販売費及び一般管理費の増加もあり前年同期比で減少しました。経常利益は当第2四半期累計期間の為替差益1,727百万円の発生が利益を押し上げたものの、前年同期に発生した為替差益5,198百万円との比較では大きく減少しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は105,494百万円（前年同期比8.2%増）、営業利益は13,035百万円（前年同期比23.6%減）、経常利益は15,217百万円（前年同期比35.4%減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は8,390百万円（前年同期比47.5%減）となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

#### (半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

現在は半導体の在庫調整局面であり、半導体製造装置は欧米顧客の発注が大きく減少するなか、相対的に良好な中国ローカルの装置メーカーからの受注を取り込むことに努めました。しかしながら、当社の真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品や半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）、部品洗浄サービスは、設備投資需要の停滞及び設備稼働率の低下の影響で売上が減少しました。一方、マテリアル製品のうち受注残のあるCVD-SiC製品は売上増を継続しました。また、石英坩堝については好調な太陽光パネル製造メーカーの受注を取り込み順調に売上を伸ばしました。

この結果、当該事業の売上高は60,257百万円（前年同期比5.5%減）、営業利益は7,788百万円（前年同期比33.5%減）となりました。

#### (電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

主力のサーモモジュールは、PCR検査装置を中心に医療関係向けの出荷が減少したことが主要因で売上減となりました。

一方、パワー半導体用基板は、産業機械向けを中心にDCB基板の販売が好調であったこと、加えて中国のEV車向けを中心にAMB基板が引き続き伸びたこともあり、全体でも大きく売上を伸ばしました。また、センサは前第2四半期連結会計期間より株式会社大泉製作所を連結化したため、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

この結果、当該事業の売上高は32,840百万円（前年同期比42.3%増）、営業利益は6,080百万円（前年同期比14.2%増）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

工作機械は前年同期比で出荷が減少しました。また、ソーブレードには前第2四半期連結会計期間より連結化した東洋刃物株式会社の売上、利益が、前第3四半期連結会計期間より含み、対前年同期比では連結化していなかった期間との比較で売上等が増加しております。

当該事業の売上高は12,396百万円（前年同期比16.5%増）、営業損失は179百万円（前年同期は営業利益398百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ65,928百万円増加し、476,576百万円となりました。これは主に現金及び預金16,936百万円、受取手形、売掛金及び契約資産4,895百万円、有形固定資産31,609百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ43,750百万円増加し、204,741百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金4,550百万円の減少があった一方、転換社債型新株予約権付社債25,000百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）22,356百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ22,178百万円増加し、271,834百万円となりました。これは主に利益剰余金5,809百万円、為替換算調整勘定9,945百万円、非支配株主持分5,978百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2023年5月15日の「2023年3月期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	103,115	120,052
受取手形、売掛金及び契約資産	53,276	58,172
商品及び製品	12,059	16,037
仕掛品	13,505	13,701
原材料及び貯蔵品	23,613	27,627
その他	9,955	11,569
貸倒引当金	△184	△203
流動資産合計	215,341	246,956
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	38,080	41,787
機械装置及び運搬具（純額）	44,171	49,784
工具、器具及び備品（純額）	5,984	6,523
土地	4,451	4,767
リース資産（純額）	11,009	11,521
建設仮勘定	35,913	56,835
有形固定資産合計	139,610	171,219
無形固定資産		
のれん	2,304	2,202
その他	4,645	4,456
無形固定資産合計	6,949	6,658
投資その他の資産		
関係会社株式	33,893	34,868
その他	15,489	17,539
貸倒引当金	△636	△667
投資その他の資産合計	48,745	51,741
固定資産合計	195,306	229,619
資産合計	410,648	476,576

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	40,524	35,973
電子記録債務	3,372	3,714
短期借入金	20,378	23,461
1年内償還予定の社債	4,723	4,398
1年内返済予定の長期借入金	11,102	14,430
未払法人税等	2,432	2,302
賞与引当金	2,913	3,204
その他	25,847	25,084
流動負債合計	111,294	112,569
固定負債		
社債	4,083	684
転換社債型新株予約権付社債	—	25,000
長期借入金	26,432	45,461
退職給付に係る負債	2,020	1,849
資産除去債務	348	409
その他	16,812	18,766
固定負債合計	49,697	92,172
負債合計	160,991	204,741
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	29,425	29,516
資本剰余金	67,961	68,084
利益剰余金	69,656	75,466
自己株式	△88	△88
株主資本合計	166,955	172,978
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	272	433
為替換算調整勘定	16,477	26,422
退職給付に係る調整累計額	23	101
その他の包括利益累計額合計	16,773	26,958
新株予約権	40	32
非支配株主持分	65,887	71,865
純資産合計	249,656	271,834
負債純資産合計	410,648	476,576

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	97,505	105,494
売上原価	62,967	71,182
売上総利益	34,538	34,311
販売費及び一般管理費	17,476	21,276
営業利益	17,061	13,035
営業外収益		
受取利息	444	933
補助金収入	1,375	1,490
為替差益	5,198	1,727
その他	362	470
営業外収益合計	7,380	4,621
営業外費用		
支払利息	435	828
持分法による投資損失	249	1,324
その他	202	285
営業外費用合計	888	2,438
経常利益	23,554	15,217
特別利益		
持分変動利益	618	24
段階取得に係る差益	204	—
特別利益合計	822	24
特別損失		
固定資産処分損	65	—
投資有価証券評価損	—	495
段階取得に係る差損	702	—
特別損失合計	768	495
税金等調整前四半期純利益	23,608	14,747
法人税等	5,639	3,433
四半期純利益	17,968	11,314
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,989	2,923
親会社株主に帰属する四半期純利益	15,979	8,390



## (四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	17,968	11,314
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△153	161
為替換算調整勘定	18,043	11,489
退職給付に係る調整額	71	78
持分法適用会社に対する持分相当額	4,218	1,689
その他の包括利益合計	22,179	13,419
四半期包括利益	40,148	24,733
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	33,176	18,574
非支配株主に係る四半期包括利益	6,972	6,158

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	23,608	14,747
減価償却費	5,596	7,913
のれん償却額	100	151
株式報酬費用	205	241
賞与引当金の増減額 (△は減少)	880	137
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	20	5
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	114	△178
受取利息及び受取配当金	△454	△946
支払利息	435	828
為替差損益 (△は益)	△2,000	△609
持分法による投資損益 (△は益)	249	1,324
段階取得に係る差損益 (△は益)	498	—
固定資産処分損益 (△は益)	65	—
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	495
持分変動損益 (△は益)	△618	△24
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,288	△830
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△5,091	△5,271
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,271	△7,532
その他	6,258	△357
小計	24,310	10,094
利息及び配当金の受取額	496	939
利息の支払額	△362	△952
法人税等の支払額	△3,456	△3,291
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,988	6,789
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の純増減額 (△は増加)	—	7,042
有形固定資産の取得による支出	△24,852	△33,235
有形固定資産の売却による収入	168	123
無形固定資産の取得による支出	△76	△187
投資有価証券の取得による支出	△4,077	△2,000
関係会社株式の取得による支出	△800	△273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	848	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△379
貸付けによる支出	—	△3
貸付金の回収による収入	3	6
その他	0	△193
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,783	△29,101

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	4,170	2,177
長期借入れによる収入	14,366	28,322
長期借入金の返済による支出	△3,717	△7,328
リース債務の返済による支出	△228	△127
社債の償還による支出	△1,434	△3,724
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	—	24,898
株式の発行による収入	—	24
非支配株主からの払込みによる収入	20,515	—
自己株式の取得による支出	△0	—
配当金の支払額	△1,195	△2,576
非支配株主への配当金の支払額	—	△36
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△9	△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	—	32
その他	△4	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,461	41,659
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,525	4,414
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	31,192	23,761
現金及び現金同等物の期首残高	52,579	95,905
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△0	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,770	119,666

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	63,791	23,073	86,865	10,640	97,505	—	97,505
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	63,791	23,073	86,865	10,640	97,505	—	97,505
セグメント利益	11,707	5,325	17,033	398	17,431	△369	17,061

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△369百万円には、セグメント間取引の消去△140百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用509百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「電子デバイス事業」セグメントにおいて、株式会社大泉製作所の株式を追加取得に伴い、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。当該事象によるのれんの増加額は3,010百万円であります。

「その他」セグメントにおいて、東洋刃物株式会社の株式を追加取得に伴い、当第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。当該事象によるのれんの増加額は212百万円であります。

## Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	60,257	32,840	93,098	12,396	105,494	—	105,494
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	60,257	32,840	93,098	12,396	105,494	—	105,494
セグメント利益又 は損失(△)	7,788	6,080	13,869	△179	13,689	△654	13,035

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△654百万円には、セグメント間取引の消去503百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用151百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## (重要な後発事象)

## (株式会社大泉製作所に対する公開買付けについて)

当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社大泉製作所（以下「対象者」といいます。）を当社の完全子会社とすることを企図して、対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）について公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを決議いたしました。

## 1. 公開買付けの目的

当社は、2022年8月1日付で、対象者を連結子会社化以降、対象者との間で、資本業務提携契約に基づく協業として、当社の中国子会社におけるサーミスタの製造工場の立ち上げを行う等中国でのサーミスタ事業の推進や対象者の構造改革等、資本業務提携の一定の成果が出てきている一方で、顧客の在庫調整や海外における日系電動車の販売不振等による外部環境の悪化により、連結子会社化時点の状況と比較して更にスピード感をもって対象者の企業価値向上を図る必要性が高まりました。

このような状況の下、当社としては、対象者が競争優位性を維持し、持続的に成長していくためには、対象者を含む当社グループの経営資源（各種人材・財務基盤・顧客基盤・自動化ノウハウ等）をこれまで以上に迅速かつ柔軟に相互活用することにより、中国を中心とした成長施策を通じた事業モデルの変革と、事業領域及びケイパビリティの大幅かつ急速な拡充が不可欠であると認識しました。

その結果、当社は、完全子会社化によって、当社と対象者の構造的な利益相反の解消を図り、対象者を含む当社グループの経営資源をこれまで以上に迅速かつ柔軟に相互活用できる体制を整えることで、当社グループ及び対象者グループ双方の企業価値の最大化を図ることを目的としております。

なお、当社は、2023年9月30日時点で、対象者株式4,722,000株（議決権所有割合51.0%）を所有していません。

## 2. 対象者の概要

名称	株式会社大泉製作所
事業内容	半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品・温度センサの製造・販売
資本金	1,480百万円（2023年9月30日現在）

## 3. 買付期間

2023年11月13日から2023年12月25日まで

## 4. 決済の開始日

2023年12月29日

## 5. 買付価格

普通株式1株につき、金1,300円

## 6. 買付予定数

4,536,790株

本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を1,450,500株と設定しています。応募株券等の総数が買付予定数の下限（1,450,500株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付を行いません。

## 7. 買付代金

5,897百万円（予定）

買付代金は、本公開買付けに対象者の全株主（当社除く）が応募した場合の買付予定数（4,536,790株）に1株あたりの本公開買付け価格1,300円を乗じた金額を記載しております。

## 8. 上場廃止となる見込み及びその事由

対象者株式は、現在、東京証券取引所グロース市場に上場されておりますが、当社は、本公開買付けにおいて買付予定数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。

また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、当社は、本公開買付けの成立後、適用法令に従い、対象者株式の全ての取得を目的とした手続きを実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所グロース市場において取引することはできません。

## 9. 支払資金の調達方法

自己資金を充当予定

(重要な子会社の設立)

当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社である上海申和投資有限公司が以下のとおり子会社を設立することを決議いたしました。

1. 設立の目的

中国におけるセンサ事業の拡大を目的として設立するものであります。

2. 設立する子会社の概要

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| (1) 名称    | 浙江富楽徳信息技术有限公司 (予定)   |
| (2) 所在地   | 中国浙江省麗水市蓮都区経済開発区     |
| (3) 事業内容  | センサ等電子材料の製造、販売、技術開発等 |
| (4) 資本金   | 2,000百万元 (予定)        |
| (5) 出資額   | 1,020百万元 (予定)        |
| (6) 出資比率  | 51.0% (予定)           |
| (7) 設立の時期 | 2023年11月中 (予定)       |